



TOKYO ELECTRON

FACT BOOK 2016

東京エレクトロン ファクトブック 2016

CONTENTS

目次

Tokyo Electron (TEL) Overview 東京エレクトロン (TEL) の事業概要	C2	Consolidated Financial Data 連結財務データ	10
Global TEL TELの世界展開	1	Consolidated Balance Sheets 連結貸借対照表	14
Industry Data インダストリー・データ	2	Consolidated Statements of Operations 連結損益計算書	16
Semiconductor & TFT-LCD Manufacturing Process Flow 半導体製造プロセス及び TFT-LCD 製造プロセス	4	Consolidated Statements of Comprehensive Income 連結包括利益計算書	16
Consolidated Operating Results 連結業績	6	Consolidated Statements of Cash Flows 連結キャッシュ・フロー計算書	17
Semiconductor Production Equipment (SPE) and FPD/PV Production Equipment 半導体製造装置・FPD/PV 製造装置	8	Consolidated Quarterly Data 連結四半期データ	18
		Stock Information 株式情報	20

As of March 31, 2016

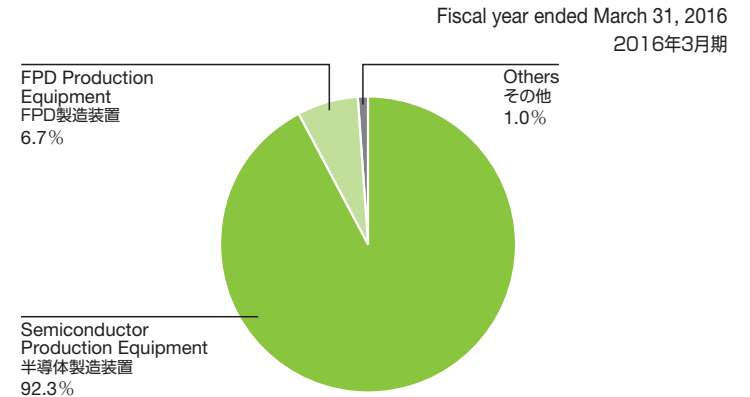
Corporate Information

会社概要

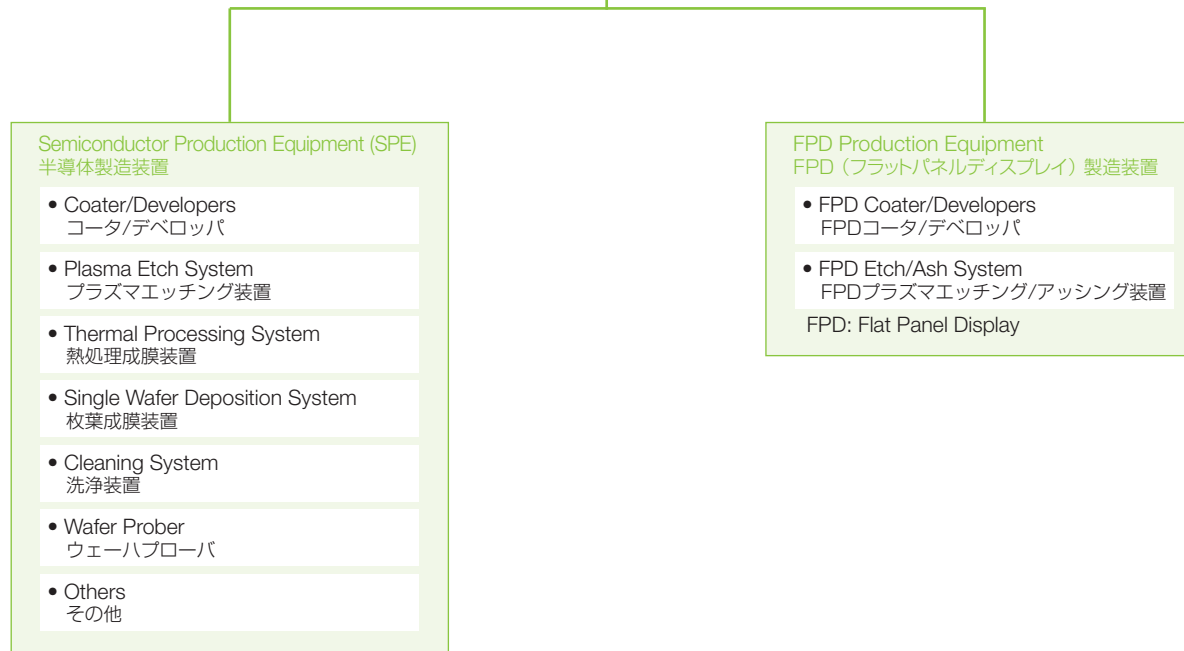
<p>Corporate Name 商号</p> <p>World Headquarters 本社所在地</p> <p>Established 設立</p> <p>Capital 資本金</p>	<p>Tokyo Electron Limited 東京エレクトロン株式会社</p> <p>Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー</p> <p>November 11, 1963 1963年11月11日</p> <p>¥54.9 Billion (as of March 31, 2016) 549億円 (2016年3月31日現在)</p>
---	---

Composition of Net Sales by Division

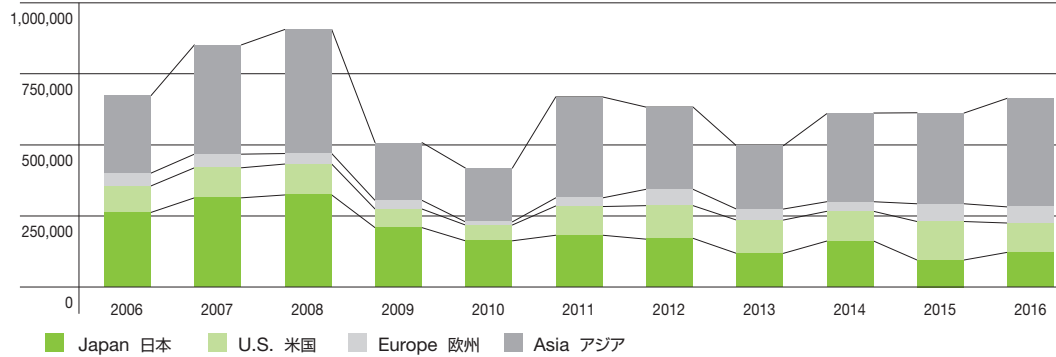
部門別売上構成比



Major Products and Services
主要取扱製品

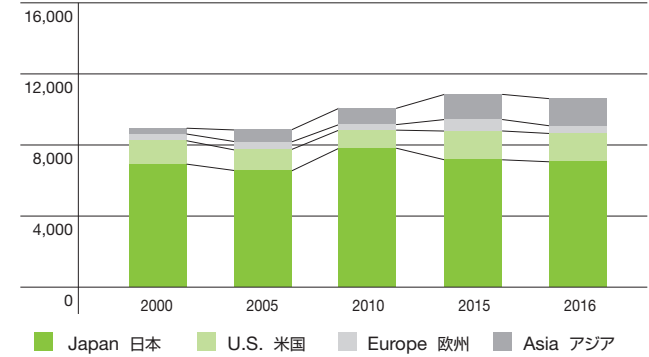


Consolidated Sales by Region
地域別連結売上高推移



FY 年度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Japan 日本	262,531	313,816	323,946	208,870	162,608	182,165	171,364	118,503	161,630	95,045	121,807
U.S. 米国	93,314	105,716	108,760	65,536	55,640	103,013	114,951	117,193	104,616	135,425	103,574
Europe 欧州	45,047	47,975	36,941	30,403	11,040	28,584	57,502	38,707	33,861	62,465	56,659
Asia アジア	272,792	384,466	436,443	203,271	189,347	354,959	289,273	222,895	312,061	320,187	381,907
Total 合計	673,686	851,975	906,091	508,082	418,636	668,722	633,091	497,299	612,170	613,124	663,948

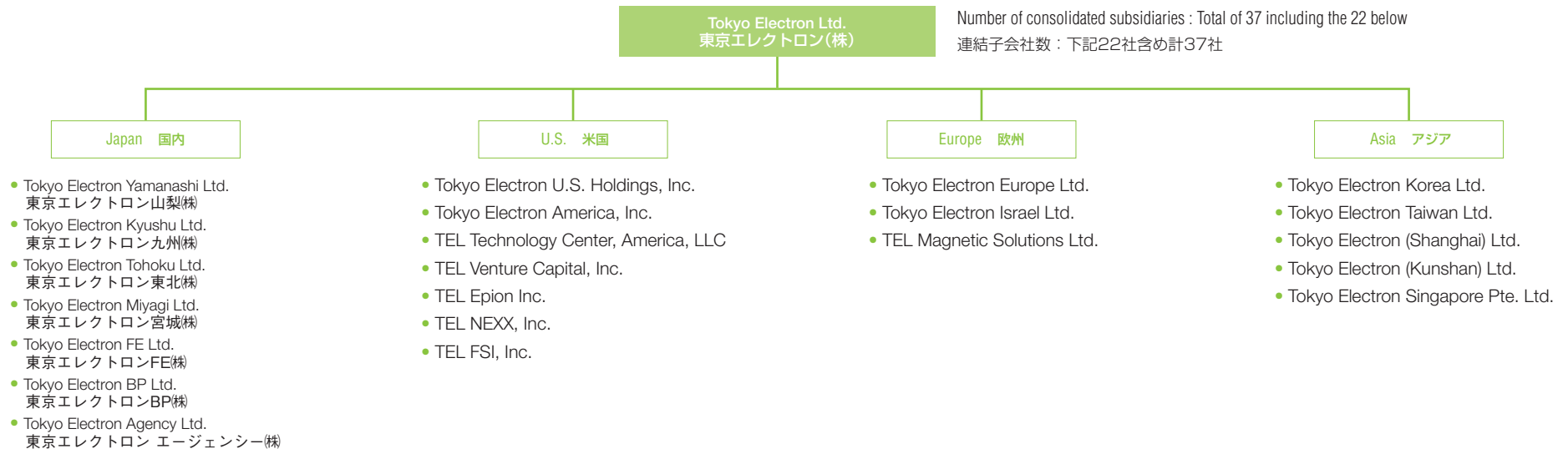
Number of Employees Worldwide
ワールドワイド人員推移

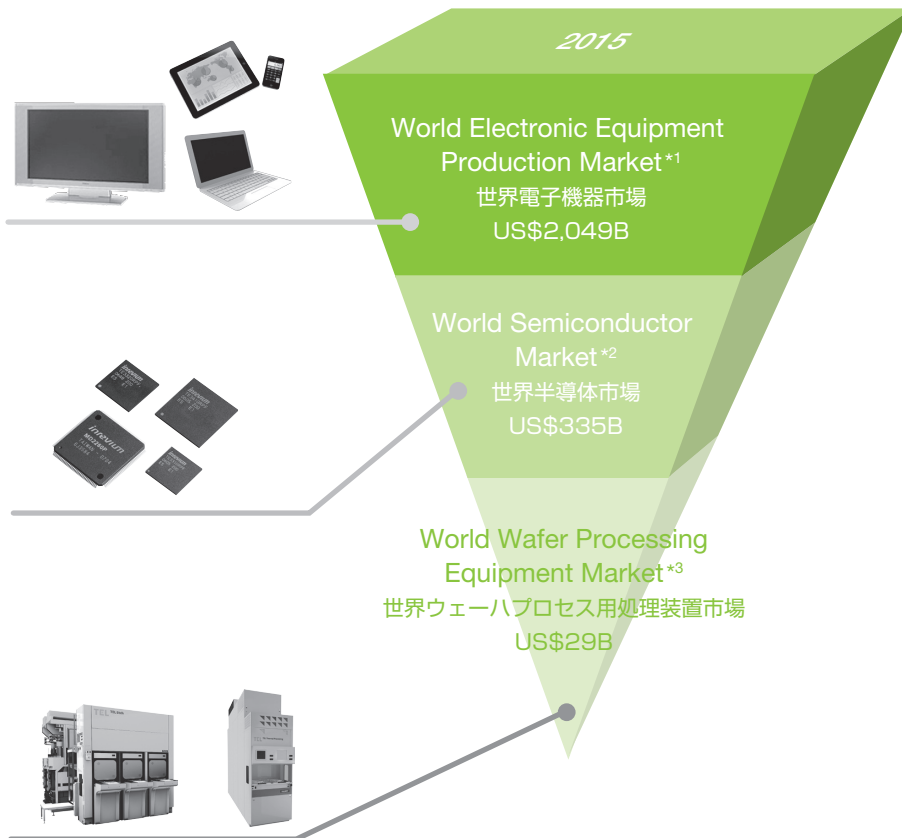


FY 年度	2000	2005	2010	2015	2016
Japan 日本	6,922	6,548	7,820	7,166	7,060
U.S. 米国	1,315	1,205	1,017	1,622	1,586
Europe 欧州	378	425	310	644	435
Asia アジア	331	686	921	1,412	1,548
Total 合計	8,946	8,864	10,068	10,844	10,629

Tokyo Electron and its Consolidated Subsidiaries 東京エレクトロンと連結子会社

As of March 31, 2016 (2016年3月31日現在)





Source 出典: *1 IHS Technology, Application Market Forecast Tool AMFT™ Q1 2016
 *2 WSTS, 30 Years WSTS Blue Book Data
 *3 SEAJ

■ World Top 10 SPE Makers
 半導体製造装置メーカー世界トップ10

CY2015 Revenue Ranking
 2015年売上高ランキング

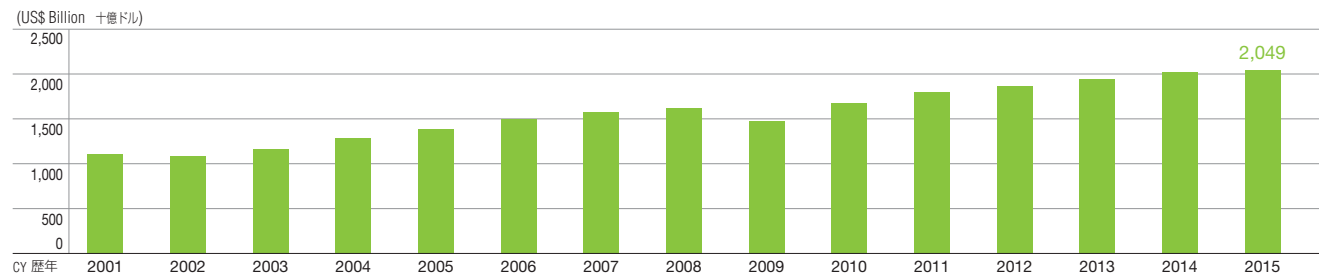
(US\$ Billion 十億ドル)

	Applied Materials アプライド マテリアルズ	8.44
	ASML エーエスエムエル	6.73
	Lam Research ラムリサーチ	5.90
	Tokyo Electron 東京エレクトロン	5.25
	KLA-Tencor ケーエルイー・テンコー	2.82
	SCREEN SCREEN	1.37
	Advantest アドバンテス	1.32
	Teradyne テラダイン	1.20
	Hitachi High-Technologies 日立ハイテクノロジーズ	0.93
	Hitachi Kokusai Electric 日立国際電気	0.88

Source 出典: The Chip Insider Equipment & Emerging Markets (VLSI Research, March 2016)

World Electronic Equipment Production Market

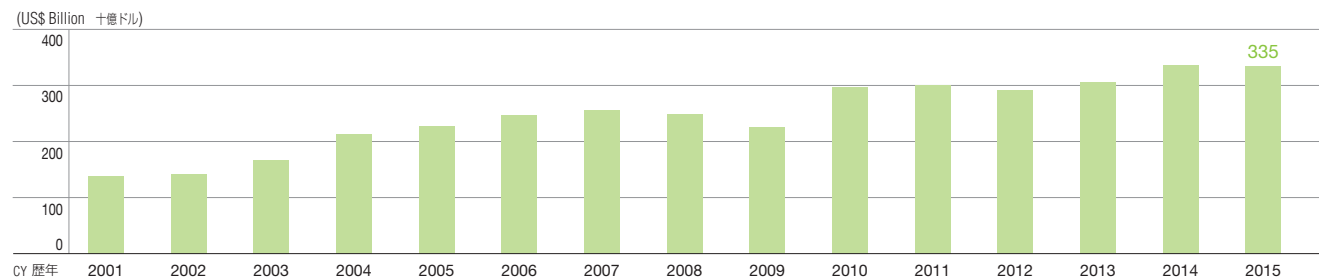
世界電子機器市場



Source 出典 : IHS Technology, Application Market Forecast Tool AMFT™ Q1 2016

World Semiconductor Market

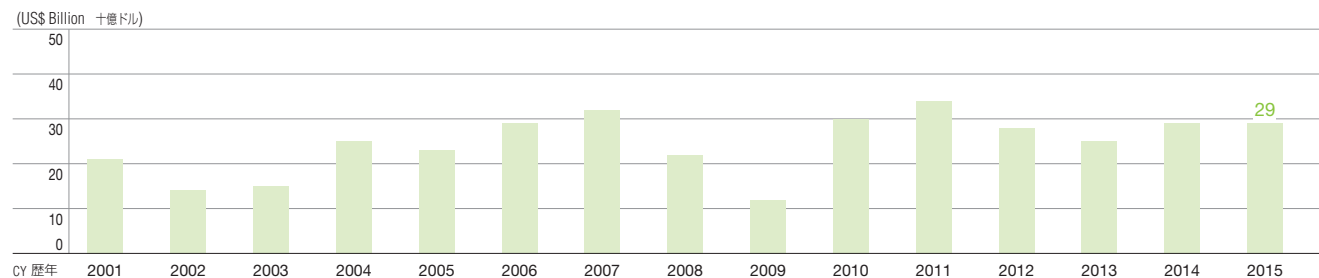
世界半導体市場



Source 出典 : WSTS, 30 Years WSTS Blue Book Data

World Wafer Processing Equipment Market

世界ウェーハプロセス用処理装置市場



Source 出典 : SEAJ

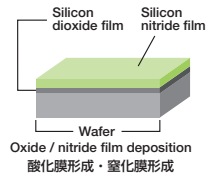
The fabrication processes (wafer processing and TFT array process) essential for manufacturing semiconductors and TFT-LCDs are similar.
半導体やTFT-LCD製造の要となる前工程（ウェーハ処理プロセス、TFTアレイプロセス）は、とにもよく似た工程です。

Semiconductor manufacturing process 半導体製造プロセス

Wafer processing ウェーハ処理プロセス（前工程）→

Pattern formation
パターン形成

Isolation formation, Gate formation
素子分離形成、ゲート形成

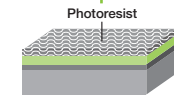


As a pre-processing procedure, the surface of a wafer is thoroughly cleaned. This is followed by thermal processing, in which a thin film of silicon dioxide or silicon nitride is formed on the wafer surface.

前処理として、ウェーハ洗浄を行い清浄な表面を準備します。熱処理成膜装置でウェーハに高温プロセス処理をし、シリコン酸化膜・シリコン窒化膜を形成します。

***Pattern design**
Various circuit modules are combined to create circuit patterns that satisfy functional requirements.
***パターン設計**
要求される機能に応じた、さまざまな回路を組み合わせ、パターン設計を行います。

****Photomask fabrication**
Reticles (photomasks) are fabricated which enable device components to be laid out by exposure as designed.
****フォトマスク作成**
設計したレイアウト通りにウェーハを焼き付けるための、パターンを描いたガラスプレート（フォトマスク）を作成します。



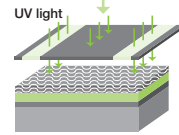
Photoresist coating
フォトレジスト塗布

While the wafer is rotated at a high speed, a thin layer of photoresist is coated uniformly on its surface.

ウェーハを高速回転させながら、フォトレジストをウェーハ全面に薄く、均一に塗布します。

*Photoresist: a light-sensitive material that changes its properties when exposed to ultraviolet (UV) light.

*フォトレジスト: UV光により性質変化が起こる感光材料



Exposure
露光

To transfer the integrated circuit pattern onto a wafer, an equipment called stepper irradiates UV light on the photoresist layer through a patterned photomask aligned over the wafer.

ICパターンを描いたフォトマスクをウェーハに合わせ、露光装置でUV光を照射し、フォトレジストにパターンを転写します。



Coater/Developers
コータ/デベロッパ
レジスト塗布現像装置
CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™ Z



Development
現像

Developing exposed photoresist leaves a particular pattern on a wafer according to the reticle (photomask) being used.

露光されたフォトレジストを現像液で溶かします。これにより、使用したフォトマスクに応じたパターンがウェーハ上に残ります。



Plasma Etch System
プラズマエッチング装置
Tactras™



Etching
エッチング

A plasma etch system removes the exposed dielectric silicon dioxide/nitride layer from the wafer surface according to the remaining photoresist.

プラズマエッチング装置で、フォトレジスト上に現像されたパターンに従って、成膜されたシリコン酸化膜・シリコン窒化膜を削り取ります。



Single Wafer Cleaning System
枚葉洗浄装置
CELLESTA™ -J



Ashing/Cleaning
レジスト剥離・洗浄

In a post-etch process, the residual photoresist is removed, and the wafer is soaked into chemical solvents to remove particles and impurities on the wafer.

エッチング後に不要になったフォトレジストを除去します。また、洗浄装置でウェーハを薬液に浸して、不純物を除去します。



Single Wafer Deposition System
枚葉成膜装置
Triase™



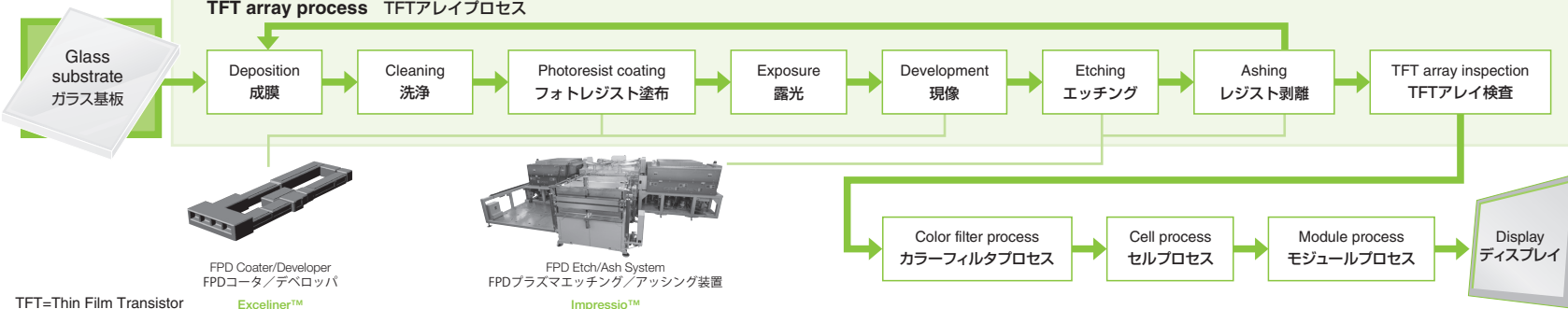
Dielectric film

A layer of dielectric material (silicon dioxide) is deposited into the patterned trenches to isolate individual transistors (elements).

形成したパターンに絶縁物であるシリコン酸化膜を埋め込み、個別トランジスタ（素子）の領域を分離します。

TFT-LCD manufacturing process TFT-LCD製造プロセス

TFT array process TFTアレイプロセス



Inspection/Assembly process 検査・組み立てプロセス (後工程) →

Contact formation
コンタクト形成

Interconnect formation
多層配線形成

Wafer probe testing
ウェーハ検査

Bump formation
ウェーハバンパ形成

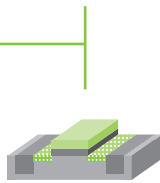
Wafer bonding/thinning/debonding
支持基盤貼り合わせ・薄化・剥離

Inspection/dicing process
ダイシング・検査

Assembly process
組み立て工程



Atomic Layer Deposition System
ALD装置
NT333™



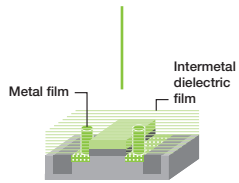
Gates are formed after gate dielectric and electrode layers are stacked by oxidation, CVD*, and/or ALD**. After that, silicon nitride layers are deposited by CVD and/or ALD.

酸化、CVD*、あるいは、ALD**法などを用いて、ゲート絶縁膜およびゲート電極を堆積・成膜し、ゲートを形成します。ゲート形成後、シリコン窒化膜をCVD、ALD法で成膜します。

* CVD : Chemical Vapor Deposition
化学気相成長
** ALD : Atomic Layer Deposition
原子層堆積



Single Water Deposition System
枚葉成膜装置
Triase™

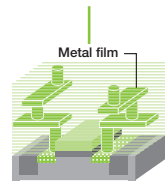


To form wiring that connects individual transistors, first a dielectric (oxide) layer is deposited over the gate layer so another layer of circuit can be laid on top. Contact holes (vias) are then opened in the dielectric layer, and are filled with metal by CVD.

個別トランジスタを繋ぐ配線を形成するため、ゲート上に層間絶縁膜を堆積・成膜し上下パターンの分離を行います。接続孔(コンタクトホール)をつくり、CVD法で金属膜を埋め込みます。



Plasma Etch System
プラズマエッチング装置
Tactras™

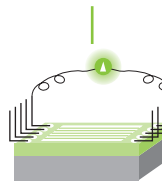


Another dielectric layer is deposited on top, in which trenches are etched to form yet another wiring pattern. The trenches are filled with a metal film, and then the excess metals are polished and the surface is planarized. These processes are repeated to make a multi level interconnect.

上下パターンの分離のため絶縁膜を堆積し、配線溝パターンをつくり、その溝(トレンチ)に金属膜を埋め込み、余分な膜を研磨・除去します。これを配線層層分繰り返します。



Wafer Prober
ウェーハプローバ
Precio™ / Precio™ XL

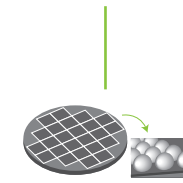


Each integrated circuit is tested by a wafer prober to find any failed circuits.

完成された集積回路の一つひとつに検査針を当てて良・不良判定を行います。



Electrochemical Deposition System
めっき装置
Stratus™



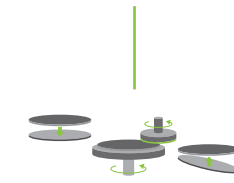
In this process, the wafer is covered with a UBM* layer and then patterned, on which metal layers are deposited to form redistribution layers and bump electrodes.

UBM*を敷いたウェーハ上にパターンを形成し、電解めっき法で、再配線層や突起電極(バンパ)となる金属膜を堆積させます。

* UBM : Under Bump Metal



Wafer Bonder/Debonder
ウェーハボンディング/デボンディング装置
Synapse™ V Plus / Synapse™ Z

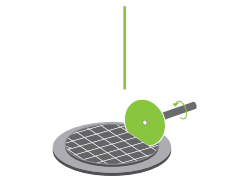


The back grinding equipment is used to reduce the wafer thickness. A support substrate or support wafer may be temporarily bonded to the wafer to facilitate grinding, and is then removed by a debonder.

裏面研磨装置でウェーハ表面を削り薄化します。支持基盤やサポートウェーハを貼り合わせる場合もあります。その後、支持基盤をデボンディング装置により剥離します。

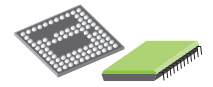


Wafer/Dicing Frame Prober
ダイシングフレームプローバ
WDF™12DP+



The wafer is diced into separate chips by a cutter, and only the good chips make it into the final assembly.

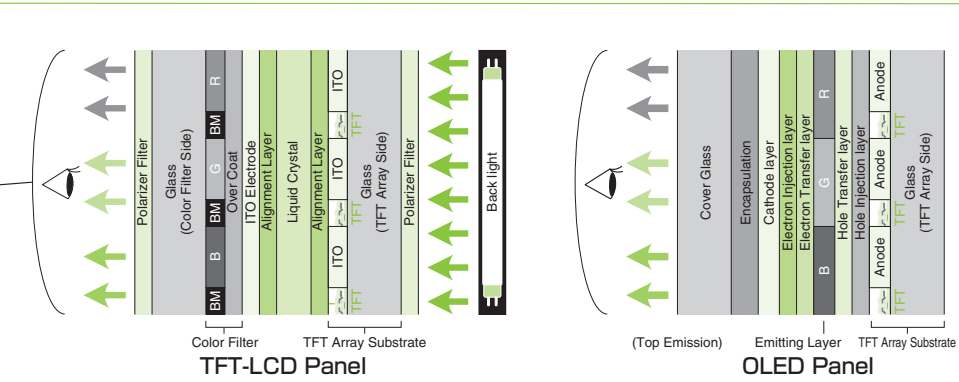
ダイシング刃でウェーハを切り出し、チップごとに分離します。分離されたチップ一つひとつに対し、良・不良判定を行います。



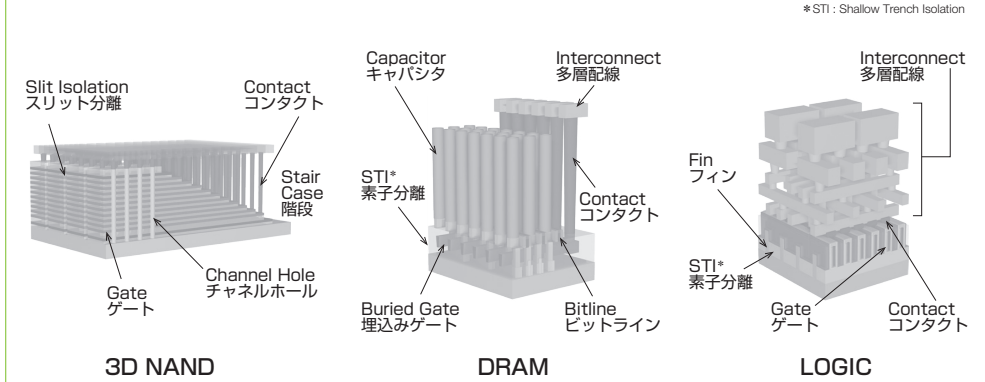
The chips are attached to package substrates or lead frames, and are sealed with ceramic or plastic.

良品チップをパッケージ基板、またはリードフレームに接続し、セラミック樹脂などに封入します。

TFT-LCD・OLED panel cross section TFT-LCD・有機EL パネル 断面図



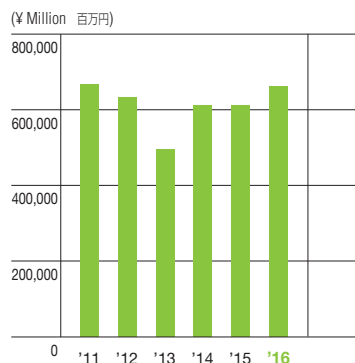
Device Architecture デバイス構造図



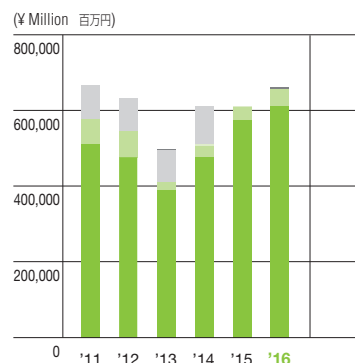
* STI : Shallow Trench Isolation

TEL's fiscal year ends on March 31. Each fiscal year described in this document is identified by the year in which it ends. For example, FY2016 is the fiscal year ended March 31, 2016. 当社は3月31日を決算日としています。本誌記載の年度は各営業期間の終了した会計年度です。例えば、FY2016は2016年3月31日に終了した会計年度です。

Net Sales 売上高

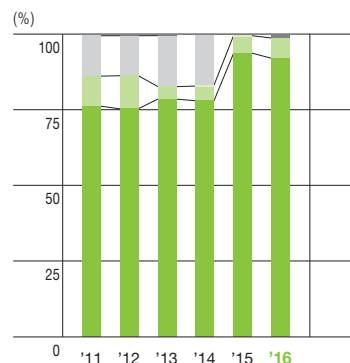


Net Sales by Division 部門別売上高

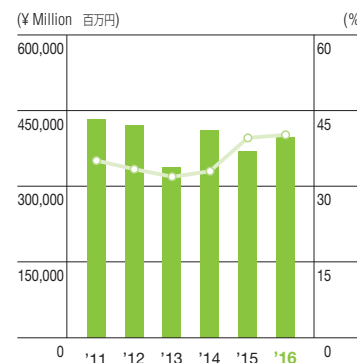


■ Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置
■ FPD Production Equipment FPD製造装置
■ PV Production Equipment PV製造装置
■ Electronic Components/Computer Networks 電子部品・情報通信機器
■ Others その他

Composition of Net Sales by Division 部門別売上構成比

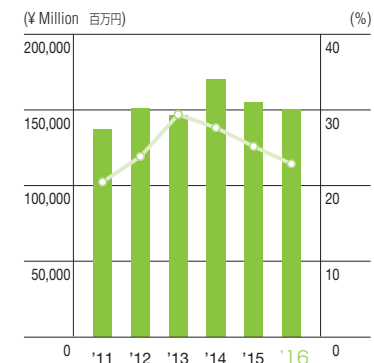


Cost of Sales and Gross Profit Margin 売上原価及び売上総利益率



■ Cost of sales 売上原価
○ Gross profit margin 売上総利益率

Selling, General and Administrative Expenses and Ratio to Net Sales 販売費及び一般管理費及び対売上高比率



■ SG&A expenses 販売費及び一般管理費
○ Ratio to net sales 対売上高比率

FY 年度	Net sales 売上高		Semiconductor Production Equipment		FPD Production Equipment		PV Production Equipment		Electronic Components & Computer Networks		Others	
	(¥ Million 百万円)	(% of total 構成比)	(¥ Million 百万円)	(%)	(¥ Million 百万円)	(%)	(¥ Million 百万円)	(%)	(¥ Million 百万円)	(%)	(¥ Million 百万円)	(%)
2011	668,722	(100.0)	511,331	(76.4)	66,721	(10.0)	—	—	90,216	(13.5)	453	(0.1)
2012	633,091	(100.0)	477,873	(75.5)	69,888	(11.0)	—	—	84,867	(13.4)	461	(0.1)
2013	497,299	(100.0)	392,026	(78.8)	20,160	(4.1)	—	—	84,664	(17.0)	448	(0.1)
2014	612,170	(100.0)	478,841	(78.2)	28,317	(4.6)	3,805	(0.6)	100,726	(16.5)	479	(0.1)
2015	613,124	(100.0)	576,242	(94.0)	32,709	(5.3)	3,617	(0.6)	—	—	555	(0.1)
2016	663,948	(100.0)	613,032	(92.3)	44,687	(6.7)	—	—	—	—	6,228	(1.0)

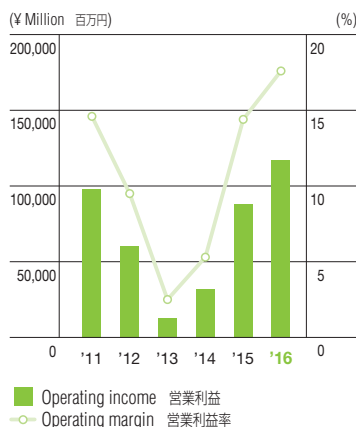
Sales by division represents the sales to customers.
部門別売上高は、外部顧客に対する売上高です。

FY 年度	Cost of sales 売上原価		Gross profit margin 売上総利益率		SG&A expenses 販売費及び一般管理費		Ratio to net sales 対売上高比率	
	(¥ Million 百万円)	(%)	(¥ Million 百万円)	(%)	(¥ Million 百万円)	(%)		
2011	433,963	35.1	136,887	20.5				
2012	421,646	33.4	151,001	23.9				
2013	338,545	31.9	146,206	29.4				
2014	410,277	33.0	169,687	27.7				
2015	370,351	39.6	154,660	25.2				
2016	396,738	40.2	150,420	22.6				

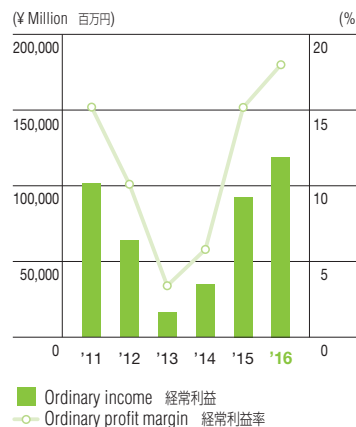
Notes: 1. From FY2011 to FY2013, PV production equipment sales are included in FPD production equipment sales. From FY2016, the sales are included in others sales.
2. From FY2015, Tokyo Electron Device, which operates the Electronic Components and Computer Networks business, changed from consolidated subsidiary to equity method affiliate.

注) 1. PV (太陽光パネル) 製造装置の売上は、2011年3月期から2013年3月期までの期間はFPD製造装置の売上を含め、2016年3月期からはその他の売上に含めて表示しています。
2. 2015年3月期より、電子部品・情報通信機器事業を行っている東京エレクトロン デバイスは、連結子会社から持分法適用関連会社となりました。

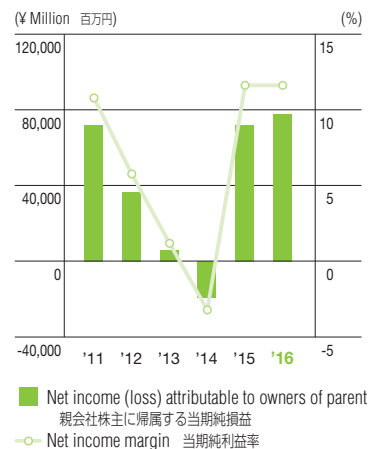
Operating Income and Operating Margin 営業利益及び営業利益率



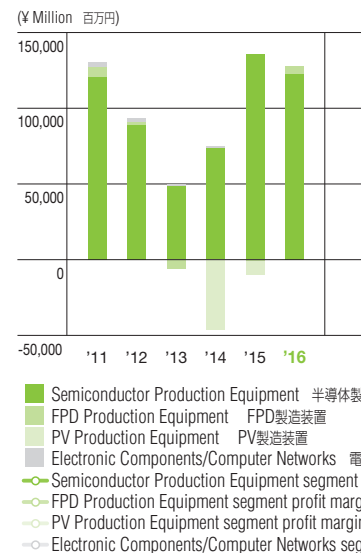
Ordinary Income and Ordinary Profit Margin 経常利益及び経常利益率



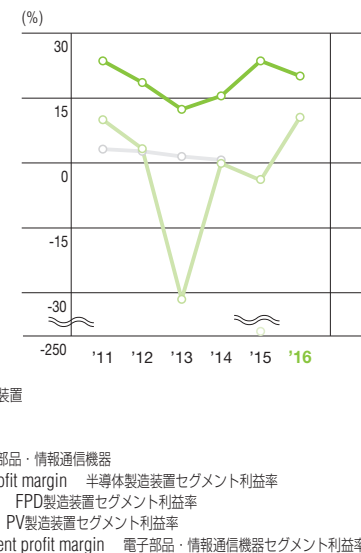
Net Income (Loss) Attributable to Owners of Parent and Net Income Margin 親会社株主に帰属する当期純損益及び当期純利益率



Segment Profit (Loss) セグメント損益



Segment Profit Margin セグメント利益率



FY	Operating income (¥ Million)	Operating margin (%)
2011	97,870	14.6
2012	60,443	9.5
2013	12,548	2.5
2014	32,204	5.3
2015	88,113	14.4
2016	116,788	17.6

FY	Ordinary income (¥ Million)	Ordinary profit margin (%)
2011	101,919	15.2
2012	64,046	10.1
2013	16,696	3.4
2014	35,487	5.8
2015	92,949	15.2
2016	119,399	18.0

FY	Net income (loss) attributable to owners of parent (¥ Million)	Net income margin (%)
2011	71,924	10.8
2012	36,725	5.8
2013	6,076	1.2
2014	(19,408)	(3.2)
2015	71,888	11.7
2016	77,891	11.7

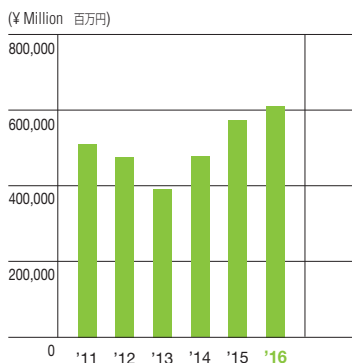
FY	Semiconductor Production Equipment		FPD Production Equipment		PV Production Equipment		Electronic Components/Computer Networks	
	Segment profit (loss)	Segment profit margin (%)	Segment profit (loss)	Segment profit margin (%)	Segment profit (loss)	Segment profit margin (%)	Segment profit (loss)	Segment profit margin (%)
2011	120,845	23.6	6,640	10.0	—	—	2,907	3.2
2012	89,019	18.6	2,271	3.3	—	—	2,311	2.7
2013	48,600	12.4	(6,355)	(31.5)	—	—	1,283	1.5
2014	74,284	15.5	(36)	(0.1)	(46,426)	—	722	0.7
2015	135,991	23.6	(1,312)	(4.0)	(8,789)	(243.0)	—	—
2016	123,162	20.1	4,747	10.6	—	—	—	—

- Notes: 1. Segment profit (loss) is based on income (loss) before income taxes.
 2. Segment profit (loss) of PV production equipment from FY2011 to FY2013 is included in segment profit (loss) of FPD production equipment. As PV Production Equipment business has been excluded from reportable segments from FY2016, it is not presented on the graph and chart of segment profit (loss).
 3. From FY2015, Tokyo Electron Device, which operates the Electronic Components and Computer Networks business, changed from consolidated subsidiary to equity method affiliate.

- 注) 1. セグメント損益は、税金等調整前当期純利益又は損失に対応しています。
 2. 2011年3月期から2013年3月期までのPV(太陽光パネル)製造装置のセグメント損益は、FPD製造装置のセグメント損益を含めて表示しています。また、2016年3月期より、PV製造装置事業を報告セグメントより除外したため、セグメント損益のグラフ及び表には表示していません。
 3. 2015年3月期より、電子部品・情報通信機器事業を行っている東京エレクトロン デバイスは、連結子会社から持分法適用関連会社となりました。

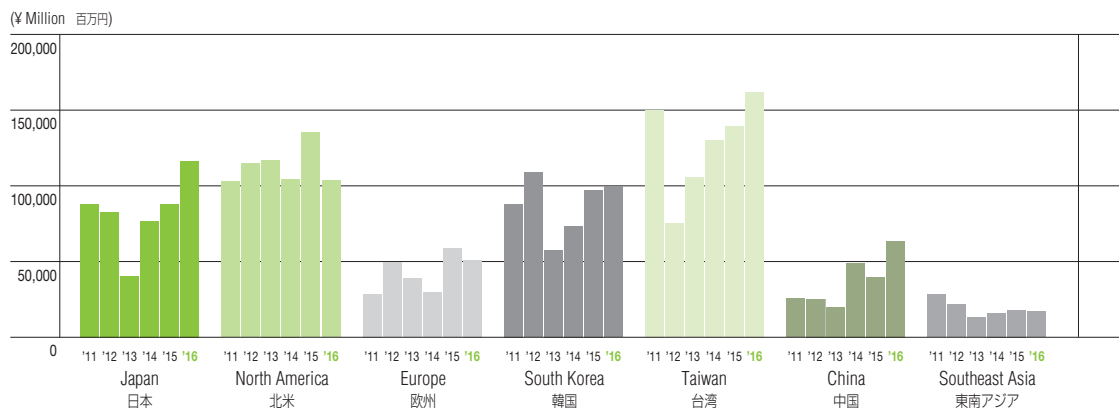
SPE Sales

半導体製造装置売上高



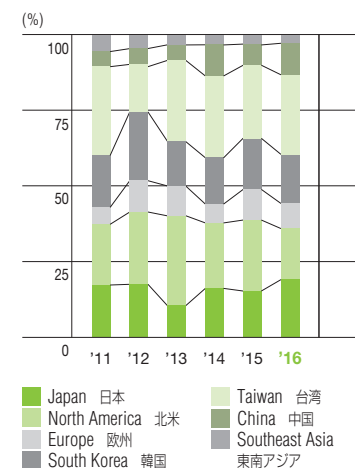
SPE Sales by Region

半導体製造装置地域別売上高



Composition of SPE Sales by Region

半導体製造装置地域別売上構成比



FY	(¥ Million 百万円) SPE sales 半導体製造装置売上高
2011	511,331
2012	477,873
2013	392,026
2014	478,841
2015	576,242
2016	613,032

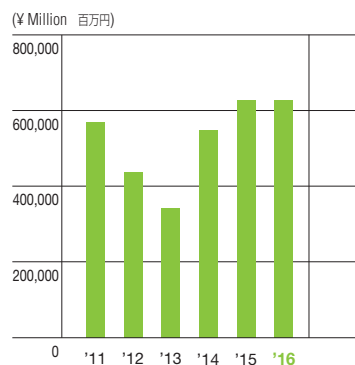
FY	Japan (% of total) 日本 構成比	North America 北米	Europe 欧州	South Korea 韓国	Taiwan 台湾	China 中国	Southeast Asia 東南アジア	(¥ Million 百万円) Total 合計
2011	87,940 (17.2)	102,898 (20.1)	28,482 (5.6)	87,858 (17.2)	150,282 (29.4)	25,593 (5.0)	28,275 (5.5)	511,331 (100.0)
2012	82,887 (17.4)	114,821 (24.0)	49,325 (10.3)	108,740 (22.8)	75,018 (15.7)	25,395 (5.3)	21,683 (4.5)	477,873 (100.0)
2013	40,278 (10.3)	117,092 (29.8)	38,701 (9.9)	57,510 (14.7)	105,386 (26.9)	19,951 (5.1)	13,104 (3.3)	392,026 (100.0)
2014	76,424 (16.0)	104,363 (21.8)	29,636 (6.2)	73,403 (15.3)	130,252 (27.2)	48,897 (10.2)	15,865 (3.3)	478,841 (100.0)
2015	87,747 (15.2)	135,341 (23.5)	58,768 (10.2)	97,364 (16.9)	139,423 (24.2)	39,713 (6.9)	17,883 (3.1)	576,242 (100.0)
2016	116,272 (19.0)	103,460 (16.9)	51,088 (8.3)	99,574 (16.2)	161,930 (26.4)	63,605 (10.4)	17,099 (2.8)	613,032 (100.0)

Notes: Geographical sales are classified according to sales destinations.

注) 地域別売上高は、販売先の所在地に基づいています。

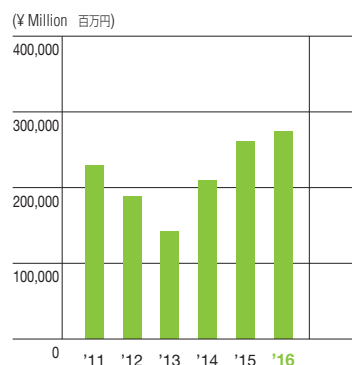
SPE Orders Received

半導体製造装置受注高



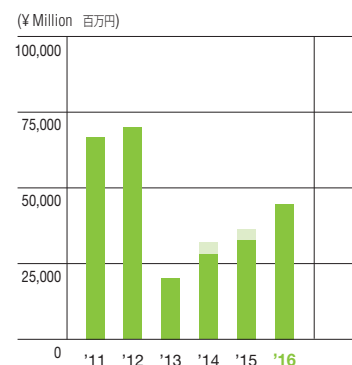
SPE Order Backlog

半導体製造装置受注残高



FPD/PV Production Equipment Sales

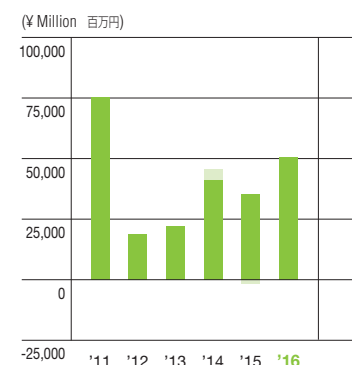
FPD/PV製造装置売上高



■ FPD Production Equipment FPD製造装置
■ PV Production Equipment PV製造装置

FPD/PV Production Equipment Orders Received

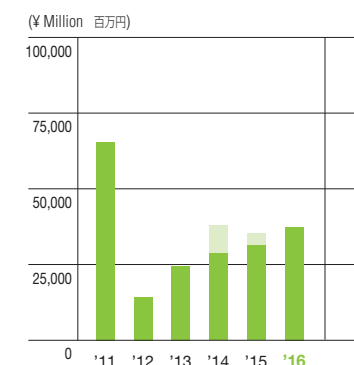
FPD/PV製造装置受注高



■ FPD Production Equipment FPD製造装置
■ PV Production Equipment PV製造装置

FPD/PV Production Equipment Order Backlog

FPD/PV製造装置受注残高



■ FPD Production Equipment FPD製造装置
■ PV Production Equipment PV製造装置

FY	(¥ Million 百万円) SPE orders received 半導体製造装置受注高
2011	567,971
2012	437,615
2013	342,547
2014	546,932
2015	626,795
2016	626,275

FY	(¥ Million 百万円) SPE order backlog 半導体製造装置受注残高
2011	228,942
2012	188,684
2013	141,616
2014	209,914
2015	260,467
2016	273,710

FY	FPD Production Equipment sales	(¥ Million 百万円) PV Production Equipment sales
2011	66,721	
2012	69,888	
2013	20,160	
2014	28,317	3,805
2015	32,709	3,617
2016	44,687	

FY	FPD Production Equipment orders received	(¥ Million 百万円) PV Production Equipment orders received
2011	75,433	
2012	18,598	
2013	21,965	
2014	41,336	4,303
2015	35,301	(1,684)
2016	50,503	

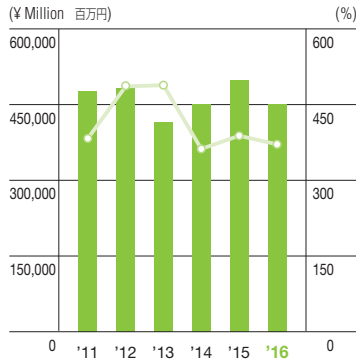
FY	FPD Production Equipment order backlog	(¥ Million 百万円) PV Production Equipment order backlog
2011	65,491	
2012	14,200	
2013	24,427	
2014	29,019	8,994
2015	31,611	3,692
2016	37,428	

Notes: From FY2011 to FY2013, sales, orders and order backlog of PV production equipment are included in those of FPD production equipment.
From FY2016, sales, orders and order backlog of PV Production Equipment have not been presented.

注) 2011年3月期から2013年3月期まで、PV (太陽光パネル) 製造装置の売上、受注、受注残はFPD製造装置の売上、受注、受注残に含めて表示しています。
また、2016年3月期より、PV製造装置の売上、受注、受注残は表示していません。

Working Capital and Current Ratio

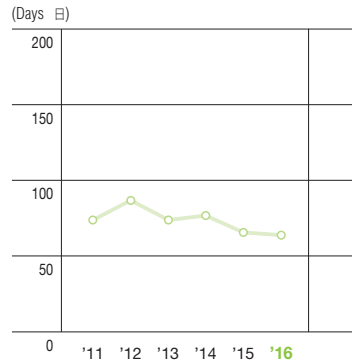
運転資本及び流動比率



■ Working capital 運転資本
○ Current ratio 流動比率

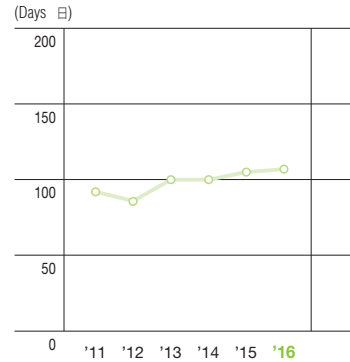
Receivable Turnover

売上債権回転日数



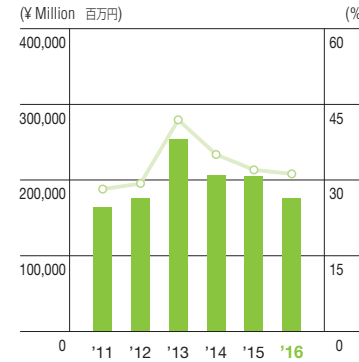
Inventory Turnover

たな卸資産回転日数



Fixed Assets and Fixed Ratio

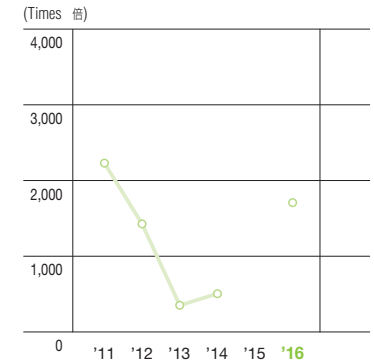
固定資産及び固定比率



■ Fixed assets 固定資産
○ Fixed ratio 固定比率

Interest Coverage Ratio

インタレスト・カバレッジ・レシオ



FY	Working capital (¥ Million)	Current ratio (%)
2011	476,193	383.4
2012	482,256	486.4
2013	414,830	488.9
2014	450,982	364.5
2015	498,070	388.2
2016	451,355	371.8

FY	Receivable turnover (Days)
2011	74
2012	87
2013	74
2014	77
2015	66
2016	64

FY	Inventory turnover (Days)
2011	92
2012	86
2013	100
2014	100
2015	105
2016	107

FY	Fixed assets (¥ Million)	Fixed ratio (%)
2011	164,973	28.2
2012	176,560	29.5
2013	254,026	42.0
2014	207,099	35.1
2015	205,271	32.0
2016	175,951	31.2

FY	Interest coverage ratio (Times)
2011	2,232.5
2012	1,428.8
2013	354.3
2014	508.6
2015	—
2016	1,709.8

Working capital = Current assets – Current liabilities
 運転資本 = 流動資産 – 流動負債
 Current ratio = Current assets / Current liabilities × 100
 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 (%)

Receivable turnover = Trade notes and accounts receivable at fiscal year-end / Net sales × 365
 売上債権回転日数 = 期末受取手形及び売掛金 ÷ 売上高 × 365

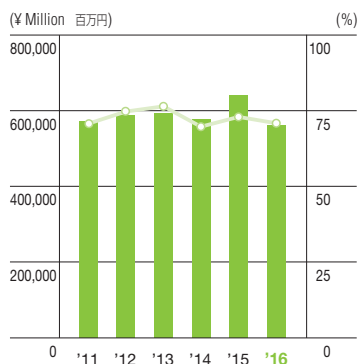
Inventory turnover = Inventories at fiscal year-end / Net sales × 365
 たな卸資産回転日数 = 期末たな卸資産 ÷ 売上高 × 365

Fixed ratio = Fixed assets / Total net assets × 100
 固定比率 = 固定資産 ÷ 純資産合計 × 100 (%)

Interest coverage ratio = (Operating income or loss + Interest and dividend income) / Interest expenses
 インタレスト・カバレッジ・レシオ = (営業損益 + 受取利息及び配当金) ÷ 支払利息 (倍)

Equity and Equity Ratio

自己資本及び自己資本比率



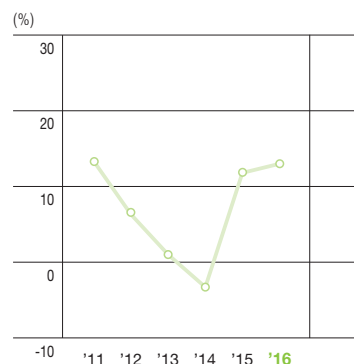
■ Equity 自己資本
○ Equity ratio 自己資本比率

FY	Equity (¥ Million)	Equity ratio (%)
2011	572,741	70.8
2012	586,789	74.9
2013	593,032	76.5
2014	578,091	69.8
2015	639,483	73.0
2016	562,369	70.9

Equity = Net assets – Subscription rights to shares
– Non-controlling interests
自己資本 = 純資産 – 新株予約権 – 非支配株主持分

Return on Equity (ROE)

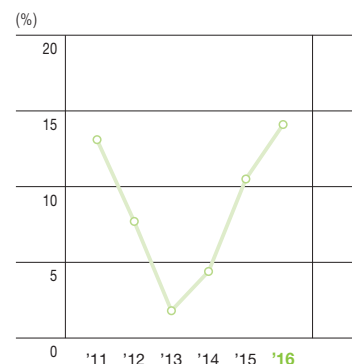
自己資本利益率



ROE = Net income (loss) attributable to owners of parent /
Average total equity × 100
自己資本利益率 = 親会社株主に帰属する当期純損益
÷ 期首・期末平均自己資本 × 100 (%)

Return on Assets (ROA)

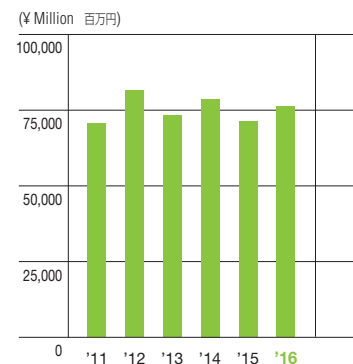
総資産利益率



ROA = (Operating income or loss + Interest and dividend income) /
Average total assets × 100
総資産利益率 = (営業損益 + 受取利息及び配当金) ÷ 期首・期末平均総資産
× 100 (%)

R&D Expenses

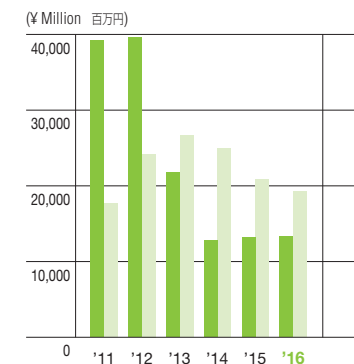
研究開発費



FY	R&D expenses (¥ Million)
2011	70,568
2012	81,506
2013	73,248
2014	78,663
2015	71,349
2016	76,286

Capital Expenditures and Depreciation and Amortization

設備投資額及び減価償却費



■ Capital expenditures 設備投資額
■ Depreciation and amortization 減価償却費

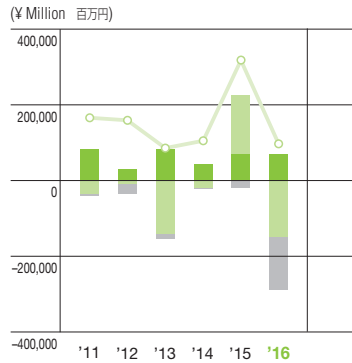
FY	Capital expenditures (¥ Million)	Depreciation and amortization (¥ Million)
2011	39,140	17,707
2012	39,541	24,197
2013	21,773	26,630
2014	12,799	24,888
2015	13,183	20,878
2016	13,341	19,257

Notes: Amortization of goodwill is not included in depreciation and amortization.

注) 減価償却費には、のれん償却額は含まれておりません。

Cash Flows

キャッシュ・フロー



- Cash flow from operating activities
営業活動によるキャッシュ・フロー
- Cash flow from investing activities
投資活動によるキャッシュ・フロー
- Cash flow from financing activities
財務活動によるキャッシュ・フロー
- Cash and cash equivalents at end of year
現金及び現金同等物期末残高

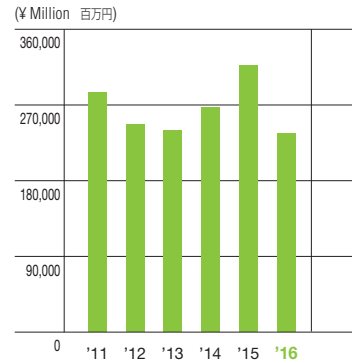
FY 年度	Cash flow from activities (¥ Million 百万元)			
	operating activities 営業活動による キャッシュ・フロー	investing activities 投資活動による キャッシュ・フロー	financing activities 財務活動による キャッシュ・フロー	Cash and cash equivalents at end of year 現金及び現金同等物期末残高
2011	83,238	(35,881)	(5,236)	165,050
2012	29,712	(8,352)	(27,334)	158,776
2013	84,266	(141,769)	(10,625)	85,313
2014	44,449	(19,599)	(186)	104,797
2015	71,806	155,737	(18,213)	317,632
2016	69,398	(150,013)	(138,600)	95,638

Cash flows from investing activities include increases / decreases in time deposits and short-term investments with maturities over three months

投資活動によるキャッシュ・フローには、満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の増減が含まれています。

Total Liquidity on Hand

手元資金



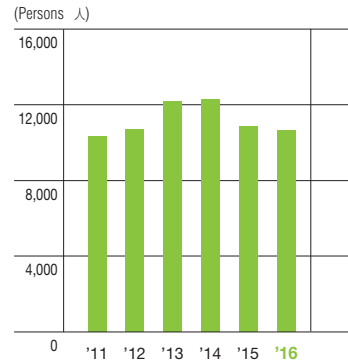
FY 年度	Total liquidity on hand (¥ Million 百万元)
	手元資金
2011	285,050
2012	247,624
2013	240,129
2014	268,146
2015	317,682
2016	236,673

Total liquidity on hand = Cash and cash equivalents at the end of the year + Time deposits and short-term investments with maturities over three months

手元資金 = 現金及び現金同等物期末残高 + 満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の残高

Number of Employees Worldwide

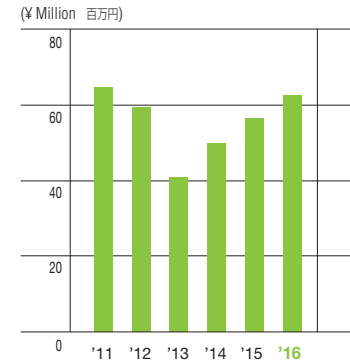
従業員数



FY 年度	Number of employees worldwide (Persons 人)
	従業員数
2011	10,343
2012	10,684
2013	12,201
2014	12,304
2015	10,844
2016	10,629

Net Sales per Employee

従業員1人当たり売上高



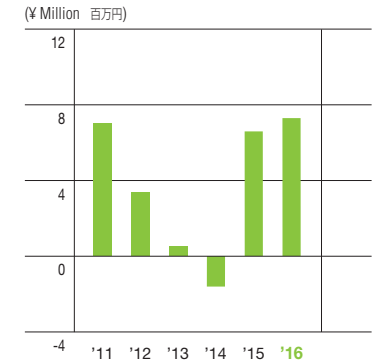
FY 年度	Net sales per employee (¥ Million 百万元)
	従業員1人当たり売上高
2011	64.7
2012	59.3
2013	40.8
2014	49.8
2015	56.5
2016	62.5

Net sales per employee = Net sales / Number of employees worldwide

従業員1人当たり売上高 = 売上高 ÷ 従業員数

Net Income (Loss) per Employee

従業員1人当たり当期純損益



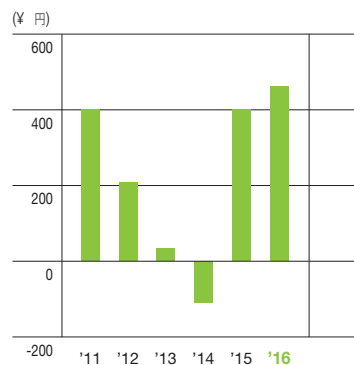
FY 年度	Net income (loss) per employee (¥ Million 百万元)
	従業員1人当たり当期純損益
2011	7.0
2012	3.4
2013	0.5
2014	(1.6)
2015	6.6
2016	7.3

Net income (loss) per employee = Net income (loss) attributable to owners of parent / Number of employees worldwide

従業員1人当たり当期純損益 = 親会社株主に帰属する当期純損益 ÷ 従業員数

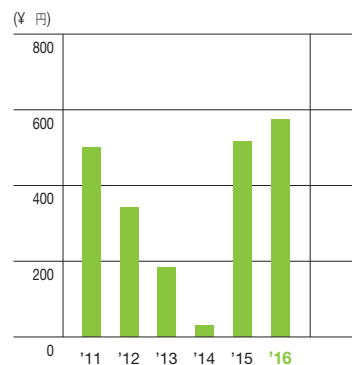
Net Income (Loss) per Share

1株当たり当期純損益



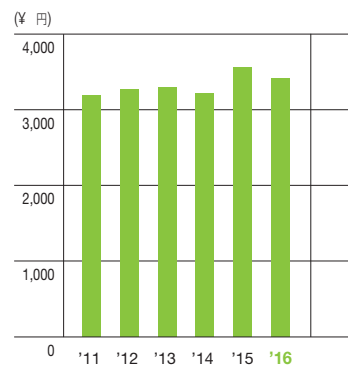
Cash Flow per Share

1株当たりキャッシュ・フロー



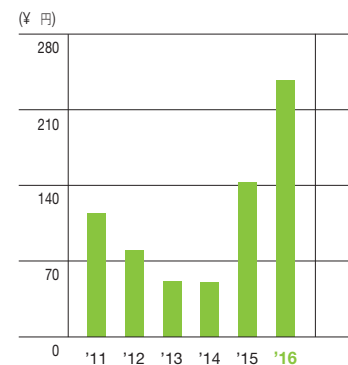
Net Assets per Share

1株当たり純資産



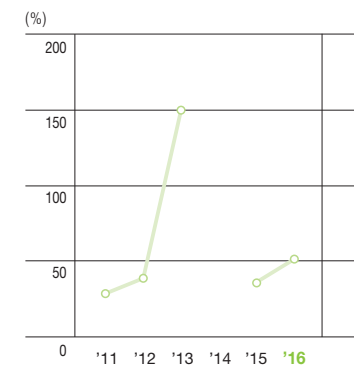
Cash Dividends per Share

1株当たり配当金



Payout Ratio

配当性向



FY	Net income (loss) per share
2011	401.73
2012	205.04
2013	33.91
2014	(108.31)
2015	401.08
2016	461.10

FY	Cash flow per share
2011	500.63
2012	340.14
2013	182.54
2014	30.58
2015	517.56
2016	575.10

FY	Net assets per share
2011	3,198.66
2012	3,275.14
2013	3,309.58
2014	3,225.92
2015	3,567.23
2016	3,428.37

FY	Cash dividends per share
2011	114.00
2012	80.00
2013	51.00
2014	50.00
2015	143.00
2016	237.00

FY	Payout ratio
2011	28.4
2012	39.0
2013	150.4
2014	—
2015	35.7
2016	51.4

Net income (loss) per share = Net income (loss) attributable to owners of parent / Average total number of shares outstanding in each fiscal year

1株当たり当期純損益 = 親会社株主に帰属する当期純損益 ÷ 期中平均発行済株式数

Cash flow per share = (Net income or loss attributable to owners of parent + Depreciation and amortization) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year

1株当たりキャッシュ・フロー = (親会社株主に帰属する当期純損益 + 減価償却費) ÷ 期中平均発行済株式数

Net assets per share = Net assets / Total number of shares outstanding

1株当たり純資産 = 期末純資産 ÷ 期末発行済株式数

Cash dividends per share = Cash dividends / Total number of shares outstanding

1株当たり配当金 = 期末配当金 ÷ 期末発行済株式数

Payout ratio = Cash dividends per share / Net income per share × 100

配当性向 = 1株当たり配当金 ÷ 1株当たり当期純利益 × 100 (%)

Notes: 1. The number of shares outstanding excluding the treasury stock is used for calculation of per share data.
2. FY2013 51 yen dividends include 20 yen memorial dividend of 50th anniversary.

注) 1. 1株当たり指標の計算には自己株式数を控除後の発行済株式数を使用しています。
2. 2013年3月期の配当金51円には、創立50周年記念配当20円が含まれています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Assets 資産の部											
Current assets 流動資産											
Cash and deposits 現金及び預金	140,023	59,389	67,540	51,156	56,939	52,992	35,834	49,632	56,345	79,382	75,674
Securities 有価証券	—	75,019	136,022	159,001	187,000	232,057	211,790	190,497	211,800	238,532	160,999
Trade notes and accounts receivable 受取手形・売掛金	169,038	228,688	224,170	119,687	124,462	136,385	150,305	100,500	129,032	110,845	116,503
Inventories たな卸資産	163,745	194,840	161,151	134,242	138,450	168,925	149,469	135,697	168,276	175,587	195,079
Deferred income taxes 繰延税金資産	21,356	28,325	24,140	11,480	26,625	27,609	23,546	15,669	25,173	27,671	31,203
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(164)	(127)	(62)	(20)	(176)	(1,153)	(1,376)	(1,179)	(1,502)	(378)	(48)
Others その他	23,488	24,225	27,271	30,139	19,638	27,414	37,480	30,682	32,365	39,241	38,003
Total current assets 流動資産合計	517,487	610,363	640,233	505,687	552,939	644,231	607,050	521,501	621,492	670,882	617,416
Property, plant and equipment 有形固定資産											
Total property, plant and equipment 有形固定資産	227,354	244,422	244,241	251,428	249,468	271,579	295,071	335,028	308,790	312,836	304,464
Accumulated depreciation 減価償却累計額	(132,616)	(139,492)	(140,135)	(151,521)	(157,340)	(159,027)	(168,186)	(199,330)	(196,446)	(205,939)	(208,147)
Net property, plant and equipment 有形固定資産合計	94,738	104,930	104,105	99,906	92,127	112,551	126,885	135,697	112,344	106,896	96,316
Intangible assets 無形固定資産	16,709	19,399	13,253	10,760	5,586	4,212	4,703	59,918	29,556	27,566	17,603
Investments and other assets 投資その他の資産											
Investment securities 投資有価証券	14,860	14,642	8,837	9,131	14,720	15,725	16,081	18,669	20,026	23,934	19,914
Deferred income taxes 繰延税金資産	13,174	13,691	14,846	31,939	20,505	20,727	17,585	23,205	23,223	18,347	20,781
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(374)	(297)	(301)	(7,545)	(7,452)	(2,031)	(3,848)	(2,112)	(1,866)	(1,884)	(1,825)
Others その他	6,646	7,784	11,843	19,118	17,924	13,786	15,152	18,647	23,815	30,409	23,161
Total investments and other assets 投資その他の資産合計	34,307	35,821	35,224	52,644	45,698	48,209	44,971	58,410	65,199	70,807	62,031
Total assets 資産合計	663,242	770,513	792,817	668,998	696,351	809,205	783,610	775,527	828,591	876,153	793,367

Notes: 1. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets" (August 9, 2002).
2. From FY2008, certificates of deposit that were previously included in cash and cash equivalents are classified as securities.
3. From FY2009, the Company adopts "Accounting Standard for Lease Transactions" (March 30, 2007).

注) 1. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」(2002年8月9日)を適用しています。
2. 2008年3月期より、従来現金及び預金に含めていた譲渡性預金を有価証券に含めて表示しています。
3. 2009年3月期より、「リース取引に関する会計基準」(2007年3月30日)を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

Liabilities and Net Assets 負債及び純資産の部**Current liabilities** 流動負債

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Short-term borrowings and commercial paper 短期借入金及びコマーシャルペーパー	2,100	1,712	6,069	3,806	5,105	7,996	4,402	3,756	11,531	—	—
Current portion of long-term debt 一年以内返済予定長期借入金及び社債	24,500	8,500	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—
Trade notes and accounts payable 支払手形及び買掛金	65,816	83,837	55,332	24,393	52,359	53,612	46,986	36,261	53,667	56,478	55,050
Customer advances 前受金	33,810	21,956	24,028	28,562	22,077	31,924	26,373	18,985	39,900	48,442	33,522
Income taxes payable 未払法人税等	22,895	45,657	28,239	1,751	4,355	25,328	4,288	2,285	14,014	6,196	22,460
Accrued employees' bonuses 賞与引当金	10,230	14,131	12,726	4,965	6,043	11,130	8,646	6,829	8,584	12,111	11,623
Accrued warranty expenses 製品保証引当金	12,219	14,114	9,815	6,115	5,267	7,594	8,903	8,344	10,072	10,441	8,686
Others その他	30,054	35,945	32,608	19,678	23,952	30,451	25,192	30,207	32,738	39,140	34,716
Total current liabilities 流動負債合計	201,627	225,854	198,820	89,272	119,161	168,038	124,794	106,670	170,509	172,812	166,060

Long-term debt, less current portion 長期借入金及び社債

	38,500	30,000	—	—	—	—	—	—	2,000	—	—
--	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---	---

Net liability for defined benefits 退職給付に係る負債

	38,034	40,018	43,704	47,046	49,906	52,230	54,646	56,643	53,448	51,104	55,302
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Other liabilities その他の固定負債

	3,459	4,829	5,047	3,413	3,913	4,134	5,567	7,086	12,019	11,074	7,765
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------

Total liabilities 負債合計

	281,621	300,702	247,572	139,732	172,982	224,403	185,007	170,400	237,978	234,991	229,128
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Net assets 純資産

Common stock 資本金	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961
Capital surplus 資本剰余金	78,078	78,346	78,392	78,114	78,034	78,045	78,023	78,023	78,023	78,023	78,023
Retained earnings 利益剰余金	249,938	328,026	410,866	404,435	393,970	457,658	471,186	467,920	436,174	488,816	427,618
Treasury stock at cost 自己株式	(15,116)	(12,167)	(11,369)	(11,111)	(10,900)	(10,484)	(9,747)	(9,588)	(9,478)	(9,064)	(8,050)
Total shareholders' equity 株主資本合計	367,861	449,166	532,850	526,398	516,065	580,180	594,422	591,315	559,679	612,736	552,551
Unrealized gains on securities その他有価証券評価差額金	5,117	5,853	2,172	(842)	2,504	2,807	3,575	4,214	5,592	9,463	7,902
Deferred gains or losses on hedges 繰延ヘッジ損益	—	(177)	460	66	(67)	(12)	(51)	(14)	60	122	50
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	3,921	5,332	(529)	(7,235)	(6,683)	(10,234)	(11,157)	(2,483)	5,777	12,481	6,742
Accumulated remeasurements of defined benefit plans 退職給付に係る調整累計額	—	—	—	—	—	—	—	—	6,981	4,681	(4,877)
Accumulated other comprehensive income その他の包括利益累計額合計	9,038	11,008	2,102	(8,011)	(4,247)	(7,439)	(7,633)	1,716	18,411	26,747	9,817
Share subscription rights 新株予約権	—	584	483	1,148	1,578	1,499	1,156	1,374	1,643	1,420	1,641
Non-controlling interests 非支配株主持分	4,721	9,051	9,807	9,729	9,973	10,560	10,656	10,720	10,878	257	228
Total net assets 純資産合計	381,621	469,810	545,244	529,265	523,369	584,801	598,602	605,127	590,613	641,162	564,239

Total liabilities and net assets 負債及び純資産合計

	663,242	770,513	792,817	668,998	696,351	809,205	783,610	775,527	828,591	876,153	793,367
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Notes: 1. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets" (December 9, 2005), "Accounting Standard for Directors' Bonus (November 29, 2005)", "Accounting Standard for Stock Option" (December 27, 2005), and "Accounting Standard for Business Combinations" (October 31, 2003). Accordingly, net assets for FY2006 are presented under new categories after the adoption of the new standards.
 2. From FY2009, the Company adopts "Accounting Standard for Lease Transactions" (March 30, 2007).
 3. From FY2011, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Comprehensive Income" (June 30, 2010).
 4. From FY2014, the Company adopts "Accounting Standard for Retirement Benefits" (May 17, 2012). Accrued pension and severance costs for or before FY2013 are included in Net liability for defined benefits.
 5. From FY2016, the Company adopts "Accounting Standard for Business Combinations" (September 13, 2013), "Accounting Standard for Consolidated Financial Statements" (September 13, 2013), and "Accounting Standard for Business Divestitures" (September 13, 2013).

注) 1. 2007年3月期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(2005年12月9日)、「役員賞与に関する会計基準」(2005年11月29日)、「ストック・オプション等に関する会計基準」(2005年12月27日)、「企業結合に関する会計基準」(2003年10月31日)を適用しています。それに伴い、2006年3月期の純資産の部については、新基準適用後の新区分に組み替えて表示しています。
 2. 2009年3月期より、「リース取引に関する会計基準」(2007年3月30日)を適用しています。
 3. 2011年3月期より、「包括利益の表示に関する会計基準」(2010年6月30日)を適用しています。
 4. 2014年3月期より、「退職給付に関する会計基準」(2012年5月17日)を適用しています。なお、2013年3月期以前の退職給付引当金は、退職給付に係る負債に含めて表示しています。
 5. 2016年3月期より、「企業結合に関する会計基準」(2013年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(2013年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(2013年9月13日)等を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Net sales 売上高	673,686	851,975	906,091	508,082	418,636	668,722	633,091	497,299	612,170	613,124	663,948
Cost of sales 売上原価	483,954	579,325	594,794	370,673	310,320	433,963	421,646	338,545	410,277	370,351	396,738
Gross profit 売上総利益	189,731	272,649	311,297	137,408	108,316	234,758	211,444	158,754	201,892	242,773	267,209
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	114,028	128,670	142,799	122,697	110,496	136,887	151,001	146,206	169,687	154,660	150,420
Operating income (loss) 営業利益 (損失)	75,703	143,978	168,498	14,710	(2,180)	97,870	60,443	12,548	32,204	88,113	116,788
Non-operating income 営業外収益	3,589	4,908	5,131	6,809	5,331	4,827	4,097	6,125	5,473	4,985	3,798
Non-operating expenses 営業外費用	3,340	4,946	916	964	591	778	494	1,977	2,191	149	1,187
Ordinary income 経常利益	75,951	143,940	172,713	20,555	2,558	101,919	64,046	16,696	35,487	92,949	119,399
Unusual or infrequent profit 特別利益	1,141	2,721	3,020	85	299	2,134	2,174	1,501	526	1,894	1,470
Unusual or infrequent loss 特別損失	1,765	2,247	6,513	11,004	10,626	4,475	5,619	431	47,769	8,015	14,403
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期純利益 (損失)	75,328	144,414	169,219	9,636	(7,767)	99,579	60,602	17,766	(11,756)	86,827	106,466
Income taxes 法人税等											
Current 法人税・住民税及び事業税	29,190	60,132	56,568	4,552	5,747	29,482	15,022	8,449	15,994	14,726	32,559
Deferred 法人税等調整額	(2,352)	(7,534)	5,373	(2,762)	(5,020)	(2,711)	8,400	2,958	(8,537)	172	(4,029)
Net income (loss) 当期純利益 (損失)					(8,493)	72,807	37,179	6,358	(19,213)	71,928	77,936
Net income attributable to non-controlling interests 非支配株主に帰属する当期純利益	484	553	1,005	303	539	883	453	282	195	40	44
Net income (loss) attributable to owners of parent 親会社株主に帰属する当期純利益 (損失)	48,005	91,262	106,271	7,543	(9,033)	71,924	36,725	6,076	(19,408)	71,888	77,891

Consolidated Statements of Comprehensive Income | 連結包括利益計算書

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Net income (loss) 当期純利益 (損失)					(8,493)	72,807	37,179	6,358	(19,213)	71,928	77,936
Other comprehensive income (loss) その他の包括利益											
Changes in fair value of investment securities 其他有価証券評価差額金					3,349	303	768	651	1,365	3,868	(1,555)
Changes in deferred gains (losses) on hedging instruments 繰延ヘッジ損益					(151)	71	(68)	55	91	69	(111)
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定					545	(3,584)	(925)	8,760	6,867	6,642	(5,705)
Remeasurements of defined benefit plans 退職給付に係る調整額					—	—	—	—	—	(2,269)	(9,233)
Share of other comprehensive income of associates accounted for using equity method 持分法適用会社に対する持分相当額					—	—	—	—	—	56	(345)
Total other comprehensive income (loss) その他の包括利益合計					3,743	(3,209)	(225)	9,467	8,324	8,366	(16,951)
Comprehensive income (loss) 包括利益					(4,750)	69,598	36,953	15,826	(10,888)	80,295	60,984
Total comprehensive income (loss) attributable to: 内訳											
Owners of parent 親会社株主に係る包括利益					(5,269)	68,732	36,531	15,425	(11,150)	80,224	60,961
Non-controlling interests 非支配株主に係る包括利益					518	866	422	400	261	70	22

Notes: 1. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets" (August 9, 2002).
 2. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus" (November 29, 2005), "Accounting Standard for Stock Option" (December 27, 2005), and "Accounting Standard for Business Combinations" (October 31, 2003).
 3. From FY2011, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Comprehensive Income" (June 30, 2010).
 4. From FY2014, the Company adopts "Accounting Standard for Retirement Benefits" (May 17, 2012).
 5. From FY2016, the Company adopts "Accounting Standard for Business Combinations" (September 13, 2013), "Accounting Standard for Consolidated Financial Statements" (September 13, 2013), and "Accounting Standard for Business Divestitures" (September 13, 2013).

注) 1. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」(2002年8月9日)を適用しています。
 2. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」(2005年11月29日)、「ストック・オプション等に関する会計基準」(2005年12月27日)、「企業結合に関する会計基準」(2003年10月31日)を適用しています。
 3. 2011年3月期より、「包括利益の表示に関する会計基準」(2010年6月30日)を適用しています。
 4. 2014年3月期より、「退職給付に関する会計基準」(2012年5月17日)を適用しています。
 5. 2016年3月期より、「企業結合に関する会計基準」(2013年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(2013年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(2013年9月13日)等を適用しています。

		(¥ Million 百万円)										
Years ended March 31 3月31日終了の会計年度		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cash flows from operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー												
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期純利益 (損失)		75,328	144,414	169,219	9,636	(7,767)	99,579	60,602	17,766	(11,756)	86,827	106,466
Depreciation and amortization 減価償却費		19,170	18,820	21,413	23,068	20,001	17,707	24,197	26,630	24,888	20,878	19,257
(Increase) decrease in trade notes and accounts receivable 売上債権の増減額		5,144	(58,352)	2,473	102,412	(4,890)	(13,319)	(15,540)	57,549	(25,357)	(1,318)	(8,649)
(Increase) decrease in inventories たな卸資産の増減額		(5,467)	(31,584)	28,342	21,282	(4,868)	(36,532)	16,022	20,278	(32,088)	(26,849)	(23,535)
Increase (decrease) in trade notes and accounts payable 仕入債務の増減額		6,743	17,236	(27,373)	(29,942)	27,975	1,667	(5,807)	(15,481)	15,605	9,432	31
Income taxes (paid) refund 法人税の支払額または還付額		(19,524)	(37,785)	(73,721)	(40,836)	5,679	(7,583)	(47,628)	(7,671)	(1,741)	(24,239)	(15,356)
Others その他		(2,539)	1,548	(3,414)	(4,590)	12,155	21,720	(2,133)	(14,805)	74,899	7,076	(8,815)
Net cash provided by operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー		78,853	54,296	116,939	81,030	48,284	83,238	29,712	84,266	44,449	71,806	69,398
Cash flows from investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー												
Payment into time deposits 定期預金の預入による支出		—	(20,000)	(20,070)	(90,944)	(90,000)	(90,000)	(35,000)	(15,056)	(98)	—	(25,000)
Proceeds from time deposits 定期預金の払戻による収入		—	20,000	20,000	60,070	90,847	90,000	55,000	15,000	9,871	5	12
Payment for purchase of short-term investments 短期投資の取得による支出		—	(10,000)	(24,000)	(262,859)	(359,000)	(270,000)	(249,500)	(177,000)	(192,515)	(24,996)	(184,490)
Proceeds from redemption of short-term investments 短期投資の償還による収入		—	10,000	14,000	159,359	382,500	270,000	260,500	111,000	174,200	188,296	68,492
Payment for purchase of property, plant and equipment 有形固定資産の取得による支出		(8,600)	(25,153)	(19,338)	(17,227)	(14,194)	(33,541)	(36,010)	(19,012)	(9,451)	(11,898)	(11,294)
Payment for acquisition of intangible assets 無形固定資産の取得による支出		(2,610)	(2,462)	(4,041)	(1,182)	(786)	(925)	(2,140)	(1,234)	(1,640)	(422)	(707)
Payment for purchase of newly consolidated subsidiaries 新規連結子会社の取得による支出		—	(4,524)	—	—	—	—	(348)	(55,079)	—	—	—
Others その他		674	6,847	3,263	(7,836)	247	(1,414)	(853)	(387)	35	4,753	2,974
Net cash used in investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー		(10,536)	(25,293)	(30,186)	(160,621)	9,613	(35,881)	(8,352)	(141,769)	(19,599)	155,737	(150,013)
Cash flows from financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー												
Increase (decrease) in debt 借入債務の増減額		(34,438)	(24,904)	(4,148)	(32,262)	1,299	2,890	(3,593)	(646)	9,551	—	—
Dividends paid 配当金の支払額		(9,795)	(12,843)	(23,431)	(13,420)	(1,431)	(8,236)	(23,101)	(9,316)	(9,138)	(17,923)	(33,013)
Payment for purchases of treasury stock 自己株式の取得による支出		(38)	(64)	(40)	(38)	(58)	(37)	(12)	(15)	(29)	(183)	(105,532)
Others その他		852	3,092	586	(294)	(96)	145	(626)	(646)	(569)	(106)	(55)
Net cash used in financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー		(43,420)	(34,719)	(27,033)	(46,015)	(287)	(5,236)	(27,334)	(10,625)	(186)	(18,213)	(138,600)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 現金及び現金同等物に係る換算差額		(340)	81	(617)	(2,068)	445	(1,009)	(299)	(5,334)	(3,973)	3,505	(2,776)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 現金及び現金同等物の増減額		24,555	(5,634)	59,103	(127,676)	58,056	41,110	(6,274)	(73,462)	20,690	212,835	(221,993)
Cash and cash equivalents at beginning of year 現金及び現金同等物期首残高		115,420	140,023	134,389	193,492	65,883	123,939	165,050	158,776	85,313	104,797	317,632
Effect of newly consolidated subsidiary 新規連結子会社の影響		48	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—
Increase (decrease) in cash and cash equivalents from changes in fiscal year-end of consolidated subsidiaries 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額		—	—	—	—	—	—	—	—	(1,206)	—	—
Cash and cash equivalents at end of year 現金及び現金同等物期末残高		140,023	134,389	193,492	65,883	123,939	165,050	158,776	85,313	104,797	317,632	95,638

Notes: From FY2016, the Company adopts "Accounting Standard for Business Combinations" (September 13, 2013), "Accounting Standard for Consolidated Financial Statements" (September 13, 2013), and "Accounting Standard for Business Divestitures" (September 13, 2013).

注) 2016年3月期より、「企業結合に関する会計基準」(2013年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(2013年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(2013年9月13日)等を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2010				2011				2012			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Net sales 売上高	68,915	84,975	114,289	150,456	144,889	173,510	159,662	190,658	153,117	173,232	129,164	177,576
Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置	30,437	51,699	76,511	103,743	103,166	137,063	115,373	155,728	120,836	127,557	91,596	137,882
FPD Production Equipment FPD製造装置	19,943	10,799	16,686	23,931	20,306	12,553	21,992	11,867	12,536	24,141	16,633	16,577
PV Production Equipment PV製造装置												
Electronic Components / Computer Networks 電子部品・情報通信機器	18,445	22,354	21,028	22,644	21,321	23,754	22,222	22,917	19,648	21,388	20,865	22,964
Others その他	89	121	63	136	95	138	73	145	96	145	68	151
Cost of sales 売上原価	57,715	65,305	82,056	105,243	95,742	113,940	100,928	123,352	94,646	118,160	87,725	121,113
Gross profit 売上総利益	11,199	19,670	32,232	45,213	49,146	59,570	58,734	67,306	58,470	55,072	41,438	56,463
Gross profit margin 売上総利益率	16.3%	23.1%	28.2%	30.1%	33.9%	34.3%	36.8%	35.3%	38.2%	31.8%	32.1%	31.8%
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	25,588	26,902	26,710	31,294	30,825	35,549	32,919	37,593	35,381	41,302	35,343	38,973
Operating income (loss) 営業利益(損失)	(14,388)	(7,232)	5,521	13,918	18,321	24,020	25,815	29,713	23,088	13,770	6,094	17,489
Operating margin 営業利益率	(20.9%)	(8.5%)	4.8%	9.3%	12.6%	13.8%	16.2%	15.6%	15.1%	7.9%	4.7%	9.8%
Ordinary income (loss) 経常利益(損失)	(14,021)	(5,191)	6,573	15,198	19,063	26,043	26,667	30,145	23,751	15,970	6,998	17,326
Ordinary profit margin 経常利益率	(20.3%)	(6.1%)	5.8%	10.1%	13.2%	15.0%	16.7%	15.8%	15.5%	9.2%	5.4%	9.8%
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期純利益(損失)	(18,406)	(7,842)	3,705	14,776	19,250	25,798	26,623	27,906	23,423	15,802	6,753	14,622
Ratio of income before income taxes to net sales 税金等調整前当期純利益率	(26.7%)	(9.2%)	3.2%	9.8%	13.3%	14.9%	16.7%	14.6%	15.3%	9.1%	5.2%	8.2%
Net income (loss) attributable to owners of parent 親会社株主に帰属する当期純利益(損失)	(11,035)	(5,125)	(58)	7,186	14,727	18,726	18,667	19,802	16,636	10,021	755	9,312
Net income margin 当期純利益率	(16.0%)	(6.0%)	(0.1%)	4.8%	10.2%	10.8%	11.7%	10.4%	10.9%	5.8%	0.6%	5.2%

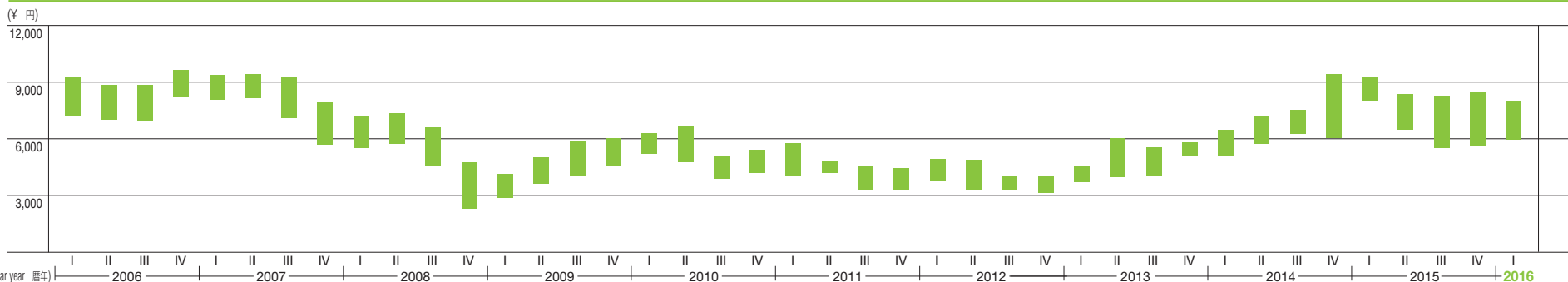
(¥ Million 百万円)

2013				2014				2015				2016			
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
134,179	132,421	91,910	138,788	103,452	151,048	138,400	219,269	151,325	142,948	137,021	181,829	155,762	185,189	158,771	164,225
108,703	105,963	68,056	109,303	74,944	119,828	102,284	181,784	136,126	136,500	131,993	171,622	140,365	176,622	146,523	149,520
4,769	4,460	4,682	6,247	4,906	4,486	8,813	10,110	13,929	5,099	3,751	9,928	10,070	8,205	11,724	14,686
20,605	21,859	19,105	23,093	2,062	1,225	1,196	(679)	1,102	1,223	1,146	145	—	—	—	—
101	137	66	142	21,426	25,359	26,029	27,910	—	—	—	—	—	—	—	—
90,067	90,895	63,659	93,922	111	146	76	144	167	125	130	132	5,326	361	522	18
44,111	41,525	28,251	44,865	73,535	100,917	88,067	147,757	95,942	90,882	79,379	104,146	90,057	114,883	96,699	95,098
32.9%	31.4%	30.7%	32.3%	29,916	50,130	50,333	71,512	55,383	52,065	57,642	77,682	65,704	70,305	62,071	69,127
34,827	38,607	35,117	37,653	28.9%	33.2%	36.4%	32.6%	36.6%	36.4%	42.1%	42.7%	42.2%	38.0%	39.1%	42.1%
9,283	2,918	(6,865)	7,211	39,563	42,305	41,266	46,552	38,313	39,019	35,560	41,766	35,425	39,334	36,558	39,102
6.9%	2.2%	(7.5%)	5.2%	(9,646)	7,824	9,067	24,959	17,069	13,045	22,081	35,916	30,279	30,970	25,513	30,025
11,248	4,211	(6,654)	7,891	(9.3%)	5.2%	6.6%	11.4%	11.3%	9.1%	16.1%	19.8%	19.4%	16.7%	16.1%	18.3%
8.4%	3.2%	(7.2%)	5.7%	(9,898)	10,487	8,502	26,395	16,913	14,860	25,005	36,169	30,207	32,177	25,655	31,359
11,231	4,307	(6,189)	8,417	(9.6%)	6.9%	6.1%	12.0%	11.2%	10.4%	18.2%	19.9%	19.4%	17.4%	16.2%	19.1%
8.4%	3.3%	(6.7%)	6.1%	(9,845)	9,524	(37,220)	25,785	15,022	14,078	24,751	32,975	29,099	28,419	25,138	23,809
5,720	370	(7,026)	7,012	(9.5%)	6.3%	(26.9%)	11.8%	9.9%	9.8%	18.1%	18.1%	18.7%	15.3%	15.8%	14.5%
4.3%	0.3%	(7.6%)	5.1%	(2,976)	5,452	(38,098)	16,212	11,835	8,181	17,451	34,420	19,481	21,895	17,858	18,656
				(2.9%)	3.6%	(27.5%)	7.4%	7.8%	5.7%	12.7%	18.9%	12.5%	11.8%	11.2%	11.4%

Notes: 1. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus" (November 29, 2005), "Accounting Standard for Stock Option" (December 27, 2005), and "Accounting Standard for Business Combinations" (October 31, 2003).
2. From FY2010 to FY2013, PV production equipment sales are included in FPD production equipment sales. From FY2016, the sales are included in others sales.
3. From FY2015, Tokyo Electron Device, which operates the Electronic Components and Computer Networks business, changed from consolidated subsidiary to equity method affiliate.
4. From FY2016, the Company adopts "Accounting Standard for Business Combinations" (September 13, 2013), "Accounting Standard for Consolidated Financial Statements" (September 13, 2013), and "Accounting Standard for Business Divestitures" (September 13, 2013).

注) 1. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」(2005年11月29日)、「ストック・オプション等に関する会計基準」(2005年12月27日)、「企業結合に関する会計基準」(2003年10月31日)を適用しています。
2. PV(太陽光パネル)製造装置の売上は、2010年3月期から2013年3月期までの期間はFPD製造装置の売上を含め、2016年3月期からはその他の売上に含めて表示しています。
3. 2015年3月期より、電子部品・情報通信機器事業を行っている東京エレクトロニクス デバイスは、連結子会社から持分法適用関連会社となりました。
4. 2016年3月期より、「企業結合に関する会計基準」(2013年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(2013年9月13日)、「事業分離等に関する会計基準」(2013年9月13日)等を適用しています。

Stock Price Range 株価の推移



Years ended March 31	各3月31日までの1年間	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
High (¥)	高値 (円)	9,270	9,650	9,410	7,360	6,290	6,670	4,950	4,905	6,489	9,451	8,450
Low (¥)	安値 (円)	5,350	6,980	5,540	2,305	3,640	3,920	3,325	3,155	3,980	5,751	5,519

PER (Times)	High	株価収益率 (倍)	最高	34.6	18.9	15.8	174.6	—	16.6	24.1	144.6	—	23.6	18.3
	Low		最低	20.0	13.7	9.3	54.7	—	9.8	16.2	93.0	—	14.3	12.0
PBR (Times)	High	株価純資産倍率 (倍)	最高	4.4	3.7	3.1	2.5	2.2	2.1	1.5	1.5	2.0	2.6	2.5
	Low		最低	2.5	2.7	1.9	0.8	1.3	1.2	1.0	1.0	1.2	1.6	1.6
PCFR (Times)	High	株価キャッシュ・フロー倍率 (倍)	最高	24.6	15.6	13.2	43.0	102.6	13.3	14.6	26.9	212.2	18.3	14.7
	Low		最低	14.2	11.3	7.8	13.5	59.4	7.8	9.8	17.3	130.2	11.1	9.6

Price / earnings ratio = Common stock price / Net income per share 株価収益率 = 株価 ÷ 1株当たり当期純利益
 Price / book value ratio = Common stock price / Net assets per share 株価純資産倍率 = 株価 ÷ 1株当たり純資産
 Price / cash flow ratio = Common stock price / Cash flow per share 株価キャッシュ・フロー倍率 = 株価 ÷ 1株当たりキャッシュ・フロー

Number of Shares Issued (Fiscal Year-End) 発行済株式数の推移 (期末)

FY 年度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Number of shares issued (Thousands) 発行済株式数 (千株)	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	165,210
Market capitalization (¥ Billion) 時価総額 (十億円)	1,466.6	1,488.2	1,094.5	657.4	1,119.8	828.1	855.2	752.2	1,142.4	1,513.9	1,212.0

Market capitalization = Closing stock price at fiscal year-end × Number of shares issued 時価総額 = 期末株式終値 × 発行済株式数

Notes: 1. Number of shares issued as of March 31, 2016 decreased 15,400 thousand shares (8.53% of issued shares before the cancellation) from March 31, 2015 due to cancellation of treasury stock.
 2. From FY2016, the number of shares issued of less than one thousand has been rounded down in the "Number of shares issued."

注) 1. 2016年3月期の期末発行済株式数は、自己株式の消却により前期末から15,400千株 (発行済株式の総数に対する割合8.53%) 減少しました。
 2. 2016年3月期より、発行済株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。

Public Offering of Common Stock 公募増資の実績

Public Offering of Common Stock 有償・公募

Date of issue 発行年月日	Subscribed shares (Thousands) 発行株式数 (千株)	Issuing price (¥) 発行価格 (円)	
June 2, 1980	1980年6月2日	4,131	1,540
July 1, 1981	1981年7月1日	2,000	4,730
October 16, 1982	1982年10月16日	4,000	3,050
May 6, 1983	1983年5月6日	20	2,550
June 23, 1984	1984年6月23日	3,000	4,015
November 15, 1989	1989年11月15日	6,000	3,233

Stock Splits 株式分割

Date of issue 発行年月日	Ratio of distribution 分割比率	
October 1, 1980	1980年10月1日	1:1.25
October 1, 1981	1981年10月1日	1:1.3
November 20, 1982	1982年11月20日	1:1.3
February 1, 1983	1983年2月1日	1:2.0
November 20, 1984	1984年11月20日	1:1.2
November 15, 1989	1989年11月15日	1:1.1
November 15, 1990	1990年11月15日	1:1.2
May 20, 1997	1997年5月20日	1:1.1

Major Shareholders (Top 10) 大株主一覧 (上位10位)

As of March 31, 2016 2016年3月31日現在

Name 株主名	Number of shares held (thousands) 持株数 (千株)	Voting share ratio (%) 持株比率 (%)
The Master Trust Bank of Japan Limited (trust account) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	24,158	14.72
Japan Trustee Services Bank Limited (trust account) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	17,385	10.59
Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. 株式会社東京放送ホールディングス	7,727	4.71
State Street Bank and Trust Company ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	4,346	2.64
Trust & Custody Services Bank, Ltd. (securities investment trust account) 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	3,583	2.18

Name 株主名	Number of shares held (thousands) 持株数 (千株)	Voting share ratio (%) 持株比率 (%)
Japan Trustee Services Bank Limited (trust account 4) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4)	3,282	2.00
BNP Paribas Securities (Japan) Limited BNPパリバ証券株式会社	2,645	1.61
State Street Bank and Trust Company 505225 ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225	2,634	1.60
State Street Bank West Client Treaty 505234 ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234	2,450	1.49
Goldman Sachs Japan Co. Ltd. ゴールドマン・サックス証券株式会社	2,329	1.42

Notes: 1. Shares of less than one thousand have been rounded down in the "Number of shares held."

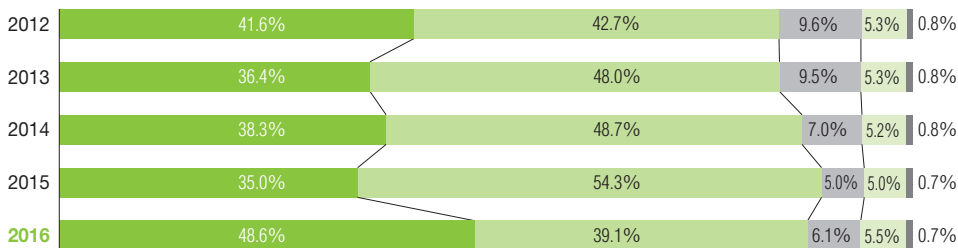
2. Voting share ratio is calculated excluding treasury stock (1,176,800 shares). Figures are truncated after the second decimal place.

注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。

2. 持株比率は、自己株式 (1,176,800株) を控除して算出しています。また、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。

Composition of Shareholders by Category 所有者別分布状況

Category 区分	2012			2013			2014			2015			2016		
	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数 (千株) 構成比			
Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社	148 75,053 41.6%	143 65,738 36.4%	109 69,145 38.3%	79 63,124 35.0%	136 80,311 48.6%										
Foreign institutions and others 外国法人等	609 77,211 42.7%	564 86,645 48.0%	556 88,001 48.7%	585 98,151 54.3%	629 64,541 39.1%										
Japanese individuals and others 個人その他	41,269 17,377 9.6%	40,205 17,260 9.5%	29,590 12,694 7.0%	19,948 9,046 5.0%	23,661 10,154 6.1%										
Other Japanese corporations その他の法人	387 9,522 5.3%	374 9,542 5.3%	307 9,360 5.2%	216 8,946 5.0%	237 9,026 5.5%										
Treasury stock 自己株式	1 1,446 0.8%	1 1,424 0.8%	1 1,408 0.8%	1 1,345 0.7%	1 1,176 0.7%										
Total 合計	42,414 180,611 100.0%	41,287 180,611 100.0%	30,563 180,611 100.0%	20,829 180,611 100.0%	24,664 165,210 100.0%										



Legend:
■ Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社
■ Foreign institutions and others 外国法人等
■ Japanese individuals and others 個人その他
■ Other Japanese corporations その他の法人
■ Treasury stock 自己株式

Notes: 1. Number of shareholders and shares includes number of odd lot shareholders and odd lot shares.

2. From FY2016, the number of shares of less than one thousand has been rounded down in the "Shares."

注) 1. 株主数及び株式数は、単元未満株主数及び単元未満株式数を含んでいます。

2. 2016年3月期より、株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。



TOKYO ELECTRON LIMITED

World Headquarters
Akasaka Biz Tower
3-1 Akasaka 5-chome, Minato-ku
Tokyo 107-6325, Japan
Tel. +81-3-5561-7000
www.tel.com

Printed on recycled paper.
本誌は再生紙を使用しています。

Printed in Japan
PR54-093